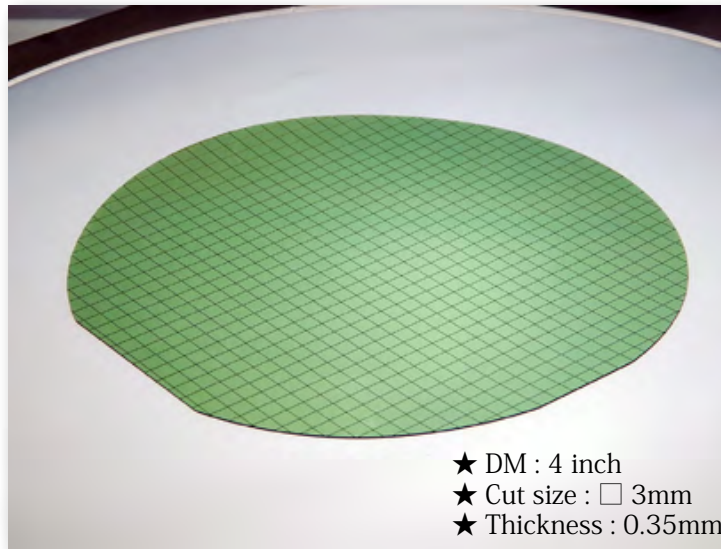




SoundCutting application

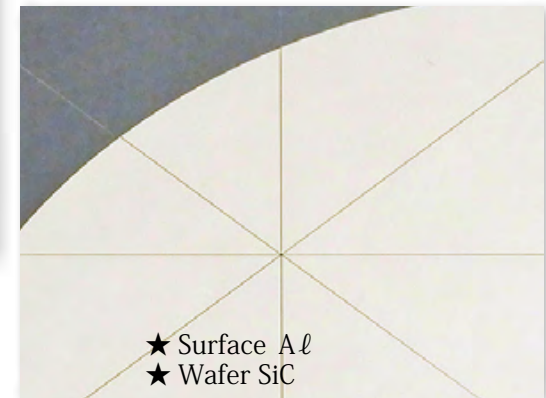
〈半導体ウェハー・SiC(炭化ケイ素)の音波フルカット〉



- ★ DM : 4 inch
- ★ Cut size : □ 3mm
- ★ Thickness : 0.35mm

半導体ウェハー・SiC(炭化ケイ素)のフルカット

- ブレードの耐摩耗性のアップ
- 大きなチッピングの防止
- 難切削材の高速カット
- ダメージが発生しない
- 歩留まり 100%



- ★ Surface Al
- ★ Wafer SiC

アルミ蒸着 SiC の放射状のフルカット

